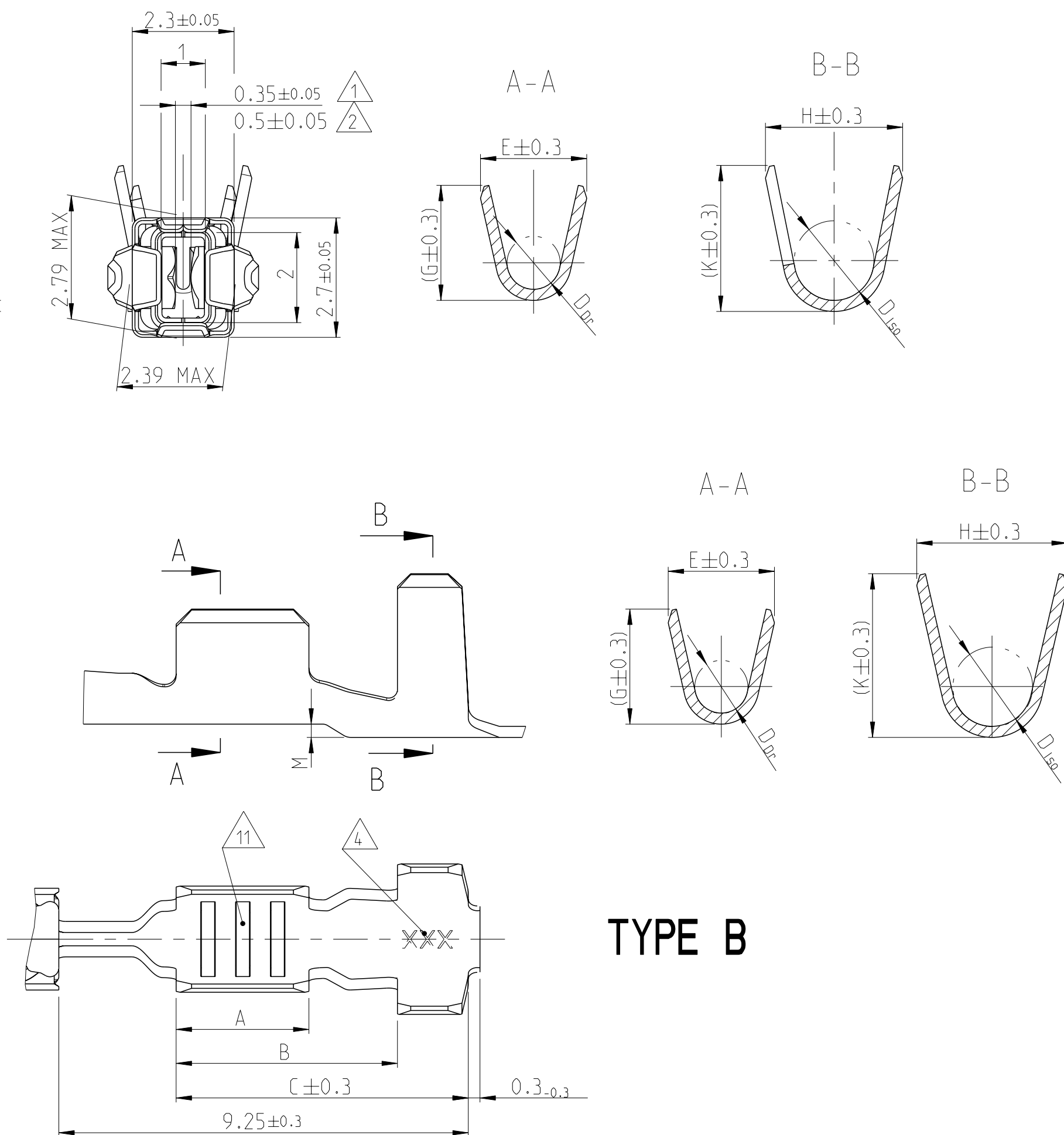
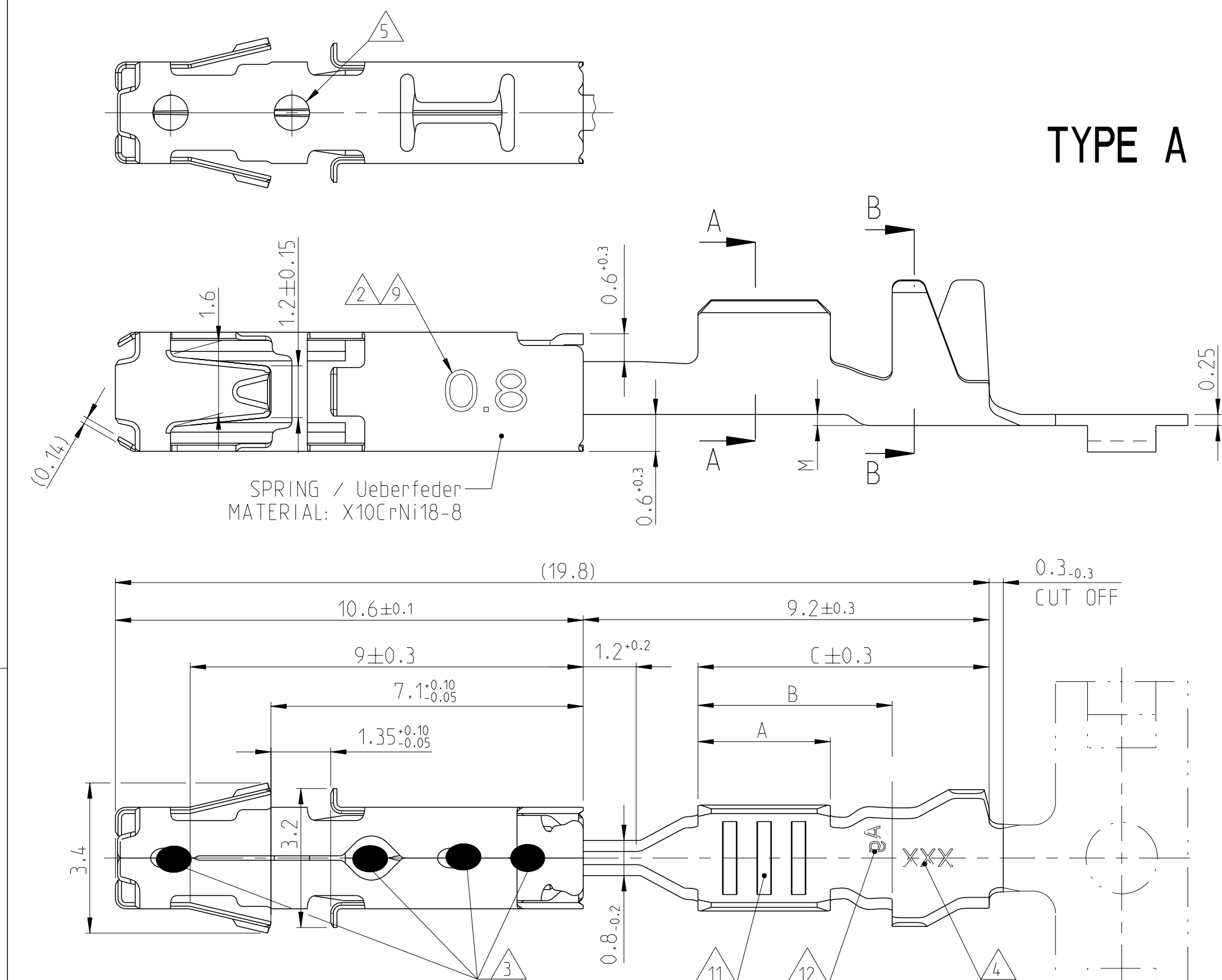
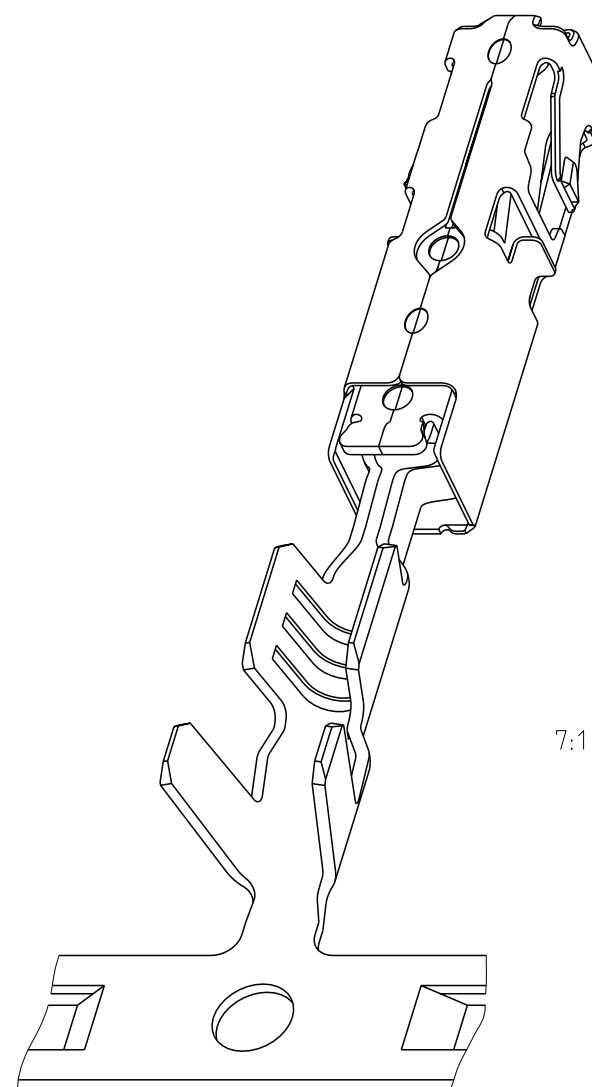
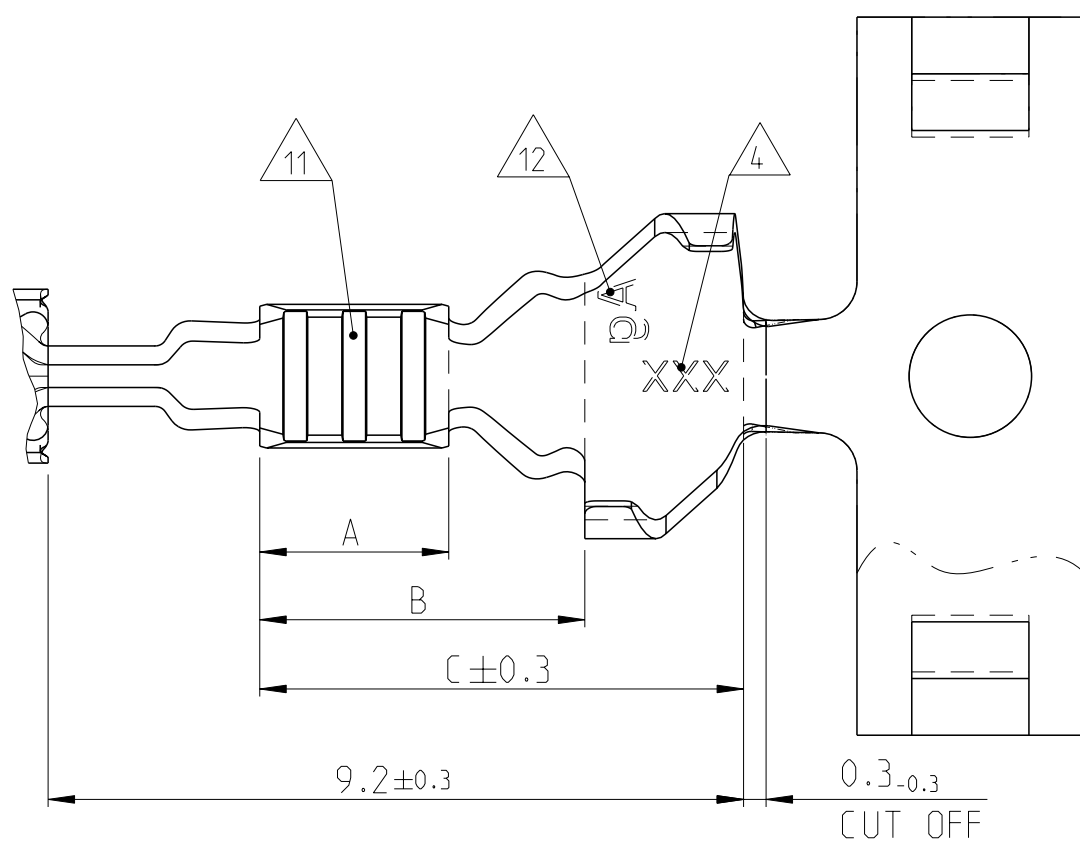
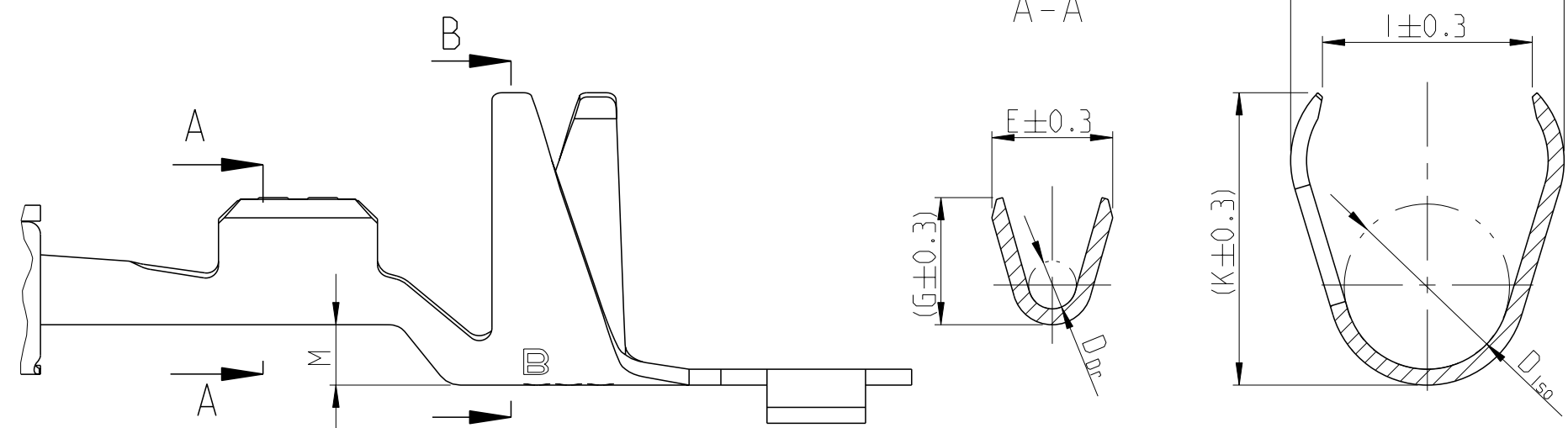


SINGLE WIRE SEALING SYSTEM



TYPE B

LE WIRE SEALING SYSTEM
Einzeldichtungssystem

Bemerkungen
NOTES

- | | | | |
|----|--|------------------|--------------------------|
| 1 | Geeignet fuer Flachsstecker
TO BE USED ON TAB | -0.2
1.5 -0.1 | x 0.6-0.07
x 0.6±0.03 |
| 2 | Geeignet fuer Flachsstecker
TO BE USED ON TAB | -0.2
1.5 -0.1 | x 0.8±0.03 |
| 3 | Laserschweissung
LASERWELDED | | |
| 4 | Kenennung fuer Werkzeug und Revisionsstand
DIE-IDENTIFICATION AND REVISION STATUS | | |
| 5 | Min. 0,8µm Goldueberzug im Kontaktbereich ueber min. 1,3µm Nickelueberzug;
min. 1µm Zinnueberzug im Crimpbereich.
Zur Kennzeichnung siehe Loch an der Ueberfeder
MIN. 0,8µm GOLDPLATE IN CONTACT AREA OVER MIN. 1,3µm NICKELPLATE;
MIN. 1µm TINPLATE IN CRIMP AREA.
AS INDEX SEE HOLE AT SPRING | | |
| 6 | Fuer Doppel- und Einzelcrimp
FOR DOUBLE AND SINGLE CRIMP | | |
| 7 | Auswahl der Einzelzeichnung entsprechend dem Isolationsdurchmesser nach Verarbeitungsspezifikation 114-10386
SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED ACCORDING TO INSULATION-DIA ACCORDING TO APPLICATION SPECIFICATION 114-10386 | | |
| 8 | Zulaessige Strombelastbarkeit siehe Drahtgrosesse
CURRENT CARRYING CAPABILITY SEE WIRE CROSS SECTION | | 1 mm² |
| 9 | Kennzeichnung fuer besonderes Offnungsmaass und Tab-Abmessung 0,8mm.
SIGNED FOR SPECIAL GAPSIZE AND TABDIMENSION 0,8mm. | | |
| 10 | 1,27µm Goldueberzug im Kontaktbereich ueber min. 1,3µm Nickelueberzug;
min. 1µm Zinnueberzug im Crimpbereich.
Zur Kennzeichnung siehe Loch an der Ueberfeder | | |
| 11 | Unterschiedliche Ausfuehrung und Anzahl der Ritlen moeglich
DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATION POSSIBLE | | |
| 12 | Kennzeichnung mit "Ag" bei Silberueberzug im Kontaktbereich
MARKING WITH "Ag" FOR SILVERPLATING IN CONTACT AREA | | |
| 13 | 1241372 nicht fuer Neuanwendung. wird ersetzt durch 1564980
1241378 nicht fuer Neuanwendung. wird ersetzt durch 1564324
1241372 SUPERSEDED BY PN 1564980
1241378 SUPERSEDED BY PN 1564324. | | |
| 14 | Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER | | |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 27AUG2004 CHK R. Liebing 30JAN2012 A. Mairoser 30JAN2012		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ± 0.2 $\pm 0^\circ$		NAME AMP MCP 1.5K PRODUCT GROUP DRAWING	
		PRODUCT SPEC 108-18716 APPLICATION SPEC 114-18386		SIZE A 1	
MATERIAL SEE TABLE TABLE Tabelle		FINISH SEE TABLE TABLE Tabelle		DRAWING NO C=124.1436	
		WEIGHT -		RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 10:1 SHEET 1 of 1 REV B21	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9